



## RE900

- Fibre de verre FR4 époxyde 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour 14 chips CMS TSOP I et 7 chips CMS TSOP II différents
- Pitch 0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil); 0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil); 1,27 mm (50 mil)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Points destinés à la rupture pour séparer des modules de la platine
- Les données Data Gerber d'apprêt pour l'établissement de l'application de pâte à braser seront mis à la disposition gratuitement
- Dimensions: 72,60 x 76,20 mm

Module-No.	Type	Pitch	Pin	Dimensions (mm)
RE900-01	TSOP I	0,400 mm	28, 40, 48, 60	12,00 x 18,00
RE900-02	TSOP I	0,500 mm	28, 32, 40, 48	12,00 x 20,00
RE900-03	TSOP I	0,500 mm	20, 24	6,00 x 16,00
RE900-04	TSOP I	0,650 mm	16, 24, 28, 36	12,00 x 14,00
RE900-05	TSOP II	0,800 mm	40, 44	11,50 x 18,80
RE900-06	TSOP II	1,270 mm	20, 24, 26, 28, 32	11,50 x 21,30